

「ミューチップ」のインレットをラミネーション技術により そのまま非接触の ID タグとして利用可能な4種類のタグを開発

耐水や耐強度を実現した「ラミネートタグ」のほか「金属専用薄型タグ」や「シールタグ」を開発



日立製作所 情報・通信グループ(グループ長&CEO:古川 一夫)と株式会社 日立産機システム(取締役社長:椎木 清彦)、大成ラミック株式会社(代表取締役社長:木村 登)は、このたび、世界最小クラスの非接触 IC チップ「ミューチップ」と外部アンテナから構成されるインレット(*1)を、ラミネーション技術(*2)を活用してタグ化することにより、そのまま非接触の ID タグとして利用可能とした4種類の「ミューチップ」タグを開発しました。

*1) インレット : IC カードや RFID タグを作成するための部品で、アンテナあるいはアンテナ接続用端子と IC チップから構成されるもの

*2) ラミネーション技術 : プラスチックフィルムやセロハンといった異種の複数のフィルムを貼り合わせる技術

「ラミネートタグ」は、ラミネート加工により最薄部で0.3mmと薄型ながら耐水性を実現した「薄型ラミネートタグ」、そして、「ミューチップ」と外部アンテナの接合部分を複合フィルムにより保護することで耐水性に加え、高い耐強度を実現した「高強度ラミネートタグ」の2種類です。従来、非接触の ID タグを企業内などで利用する場合はユーザーがインレットを購入し、使用環境に合わせてインレットをタグに加工していましたが、この「ラミネートタグ」を使用すると、最初からタグとして提供されるため、ユーザーのタグ化へのコストが削減できるほか、耐水性や耐強度などによりユーザーが想定する環境に合わせて手軽に非接触の ID タグを活用することが可能となります。

「金属専用薄型タグ」は、同じくラミネーション技術によりタグ化し、金属部分に貼り付けて最大で25cmの通信距離を確保した新しいタグです。従来は金属にインレットを貼り付けると読み込み装置(リーダー)と通信が出来なくなるという問題がありました。この「金属専用薄型タグ」は、アンテナを2層構造にすることで金属に直接貼り付けても25cmの通信距離を確保しています。そのため、従来は利用できなかった金属性の容器をつかった物品管理や筐体の管理、車両管理などにも利用可能となります。

また、「シールタグ」は、インレットの片面に粘着テープを貼り付けた「ムーチップ」のインレットです。現在使用中の社員証や学生証などのIDカードをはじめとしたさまざまなものに簡単に「シールタグ」を貼り付けられるため、手軽に非接触のIDタグとして使用することが可能となります。

なお、今回の「ラミネートタグ」と「金属専用薄型タグ」、「シールタグ」は、9月15日から17日まで東京国際展示場(東京ビックサイト)において開催される「自動認識総合展」の日立ブースで紹介する予定です。

製品に関するホームページ

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/mu-chip/jp/>

他社所有商標に関する表示

- ・ 記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ ミューソリューション事業部
開発エンジニアリング本部【担当:渡辺】
〒140 - 8573 東京都品川区南大井6丁目26番2号大森ベルポートB館
TEL : 03 - 5471 - 2102(ダイヤルイン)
E-Mail : mu-solution@itg.hitachi.co.jp

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
